

通知

中華民國 110 年 1 月 13 日

聯絡人：楊弘道組長、何鴻裕專員

電話：2717162/傳真：2717165

- 一、本案係科技部 110 年度「半導體產學研發聯盟計畫」(原產學研發聯盟 REsearch Alliance, REAL 計畫), 自即日起受理申請, 依來文須於 110 年 2 月 19 日 (星期五) 前文抵科技部, 請有意申請教師於 110 年 2 月 8 日 (星期一) 晚上 12 時前完成線上申請作業, 並於 110 年 2 月 9 日 (星期二) 中午 12 時前列印申請書首頁送至本處彙辦。
- 二、本計畫屬科技部「產學案」之數量管制件數, 核定補助後, 列入計畫主持人執行計畫件數, 共同主持人不列入計算。
- 三、本計畫合作企業現金出資不得少於新臺幣 200 萬元, 須於計畫執行期間內撥付, 且應高於向科技部申請補助經費, 並符合科技部「補助產學合作研究計畫作業要點」第 2 點規定者。
- 四、本計畫分為 IC 設計、製造及封測三組, 請於申請書之計畫名稱註明申請組別。
- 五、本案相關申請詳細資訊請參閱徵求說明書。
- 六、檢送來文及相關附件如附檔, 請各單位協助轉知所屬知悉。

此致

各學院

研究發展處敬啟